



VDA Automotive SYS Conference における Automotive SPICE の最新動向

先月 6 月 26 日から 28 日の日程で、ドイツのポツダムにて第 9 回 VDA Automotive SYS Conference が開催されました。今年のカンファレンスでは、これまでの Automotive SPICE、機能安全、セキュリティ、アジャイルのトピックスに加えて、自動運転やそれに伴う人工知能に関する発表が見られました。

Automotive SPICE に関連するモデルの動向としては、Automotive SPICE V3.1 に対応したプラグインモデルとして、すでに公開されている機械システム開発向けの PAM (SPICE for Mechanical Engineering : 以下 ME SPICE) に加えて、電気・電子系ハードウェア開発向けの PAM (Hardware SPICE)、サイバーセキュリティ向けの PAM (Cyber Security SPICE)、そして、アジャイル開発向けの PAM (Agile SPICE) の発行に向けたワーキンググループの活動が報告されました。

Hardware SPICE は 2019 年の年末、Cyber Security SPICE は 2020 年の中頃、Agile SPICE は 2020 年の上半期にそれぞれ最初のドラフトを公開する予定です。

このように、Automotive SPICE はプラグインコンセプトの導入によってカバー範囲を広げ、車載システムの開発に広く適用できるプロセスモデルへと変わっています。

本来、SPICE は Software Process Improvement and Capability dEtermination の略であり、適用対象としてソフトウェア開発を想定したものでしたが、現在の SPICE は、ソフトウェアではなくシステム全体を指すものへと完全な変化を遂げたというコメントもカンファレンスの中ではありました。

なお、これらのプラグインモデルは、現時点では Automotive SPICE の外部に定義された任意のモデルという位置づけにありますが、Automotive SPICE の発行元である VDA QMC は、これらのプラグインモデルが将来的に Automotive SPICE 本体へ集約されていく可能性を示唆しています。

カンファレンスでは、機械システム開発向けの ME SPICE についてのワークショップが開催され、機械システム開発における典型的な課題やそれらの解決に ME SPICE を活用するためのアイデアが議論されました。

ワークショップ参加者からは、以下のような課題が挙げられていましたが、その多くは日本の開発現場でも共通しているかと思えます。

- 図面から描き始めるため、機械システムの要件を整理、分析した上で、設計に落とし込まれていない
- 機械コンポーネント、電気電子ハードウェア、ソフトウェアにまたがった成果物の管理が行われていない
- 試作によるトライアンドエラーに頼った設計になってしまい、設計完了までの工数が予想できない
- 品質保証が現物の確認のみになっており、品質に再現性がない

弊社では、システム開発、ソフトウェア開発プロセス以外に、各種プラグインモデルの PAM の活用に向けたセミナーを随時開催する予定です。

その第一弾として、来る 7 月 16 日に ME SPICE に関するセミナーを開催いたします。

上記の課題のうち、機械システムにおける要件定義、設計への落とし込み、これらに付随するトレーサビリティ構築、構成管理に焦点を当て、プロセス改善のためのヒントを解説させていただく予定です。

この機会にぜひご参加をご検討いただければ幸いです。

[セミナーの詳細とお申し込みはこちら (IDAJ 社サイトからの申し込み)]

https://www.idaj.co.jp/academy/seminar/theory_practice_detail.html?courseid=203

2019/07/03 田淵 一成